

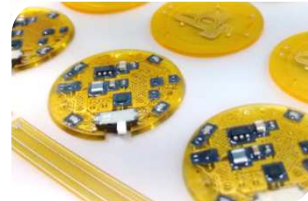
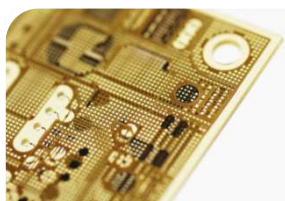


樹脂造形

部品実装

回路形成

樹脂と導体のデジタル印刷 + 超低温実装



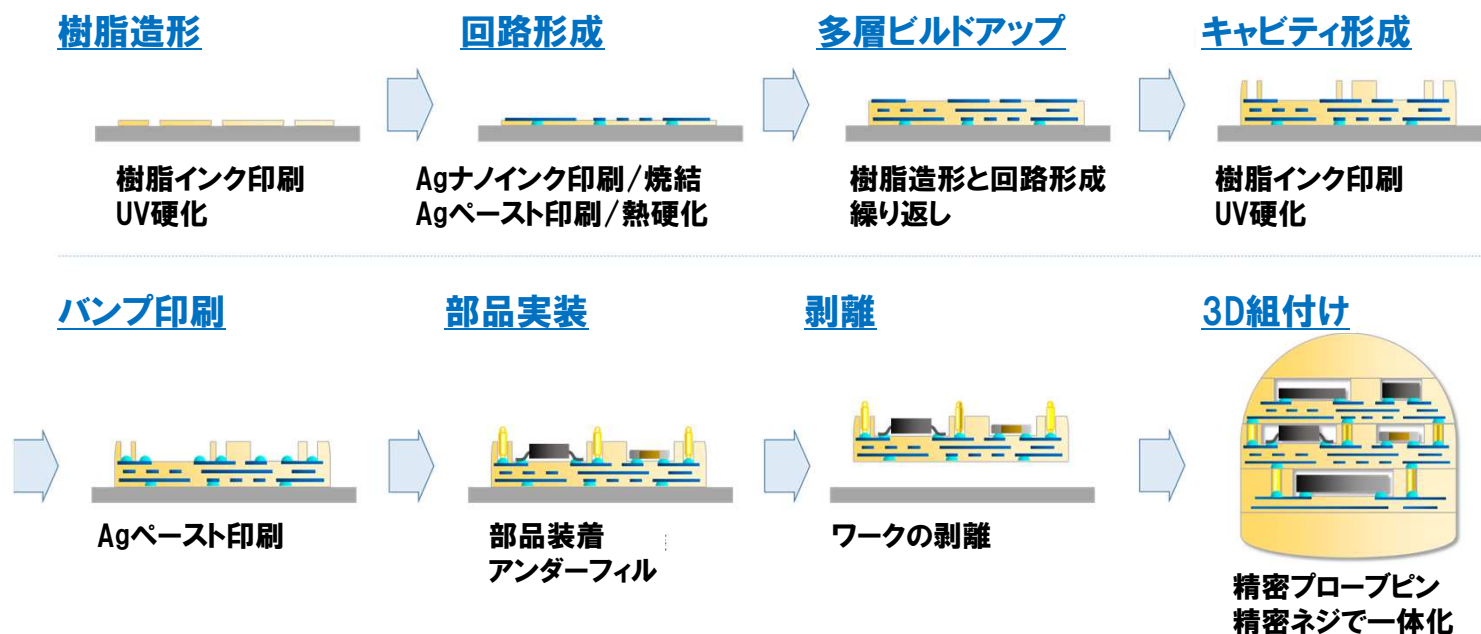
特殊形状のデバイスや短納期のPCB試作に

試作サービスの製造デザインルール

	項目	デザインルール
回路形成	導電材料	銀ナノインク
	厚み	4 or 7 um
	最小 L/S	140 / 200 um
樹脂形成	最大造形サイズ	120 x 60 mm
	最大造形厚み	4 mm
	ステージサイズ	120 x 120 mm
多層回路形成	最大層数	5 layers
	層間接続	ブラインドビアホール
部品実装	接続材料	銀ペースト
	最小電極ピッチ	0.5 mm
	最小部品サイズ	0.6 x 0.3 mm



製造のプロセスフロー



設計・プリントサービスの流れ

